技术参数

5216

日期 ：03/2023

上海禧合应用材料

应用介绍

特点	一款单组份加热固化胶黏剂，粘度适中易流平，对多种材料附着力好固化速度快，适用于电子领域元器件粘接保护，尤其使用于金线及焊线粘接固定，具有较好的抗震耐湿热性能
粘接材料	金属，塑料 PCB，玻璃，陶瓷等
典型应用	电子器件芯片金线保护固定

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色液体	
粘度(cps)	24030	10rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件	85℃/40mins 或 150℃/10mins	
适用期	8H	
有效期@ -20℃,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	85D	ASTM D-2240
拉拔强度	10MPa	硅片+FPC
TG	119℃	DSC,TAQ20，40℃/Min
热膨胀系数	a1=29ppm/℃ a2=108ppm/℃	
线性收缩率	0.002%	
可靠性	**数值**	**测试方法**
固化失重	<2%	
工作温度范围	-55℃—150℃	

高温高湿表面绝缘电阻

序号	测试条件		初始值	取出放置1H	合格标准
1	胶水	85℃，85%RH，500H	＞$1*10^{13}$Ω	＞$1*10^{13}$Ω	＞$1*10^{9}$Ω（1GΩ）
2	胶水	85℃，85%RH+1MΩ电阻+20V电压 168H	＞$1*10^{13}$Ω	$2.9*10^{10}$Ω	
3	助焊剂+胶水		＞$1*10^{13}$Ω	$2.2*10^{10}$Ω	
4	锡线+胶水		＞$1*10^{13}$Ω	$7.7*10^{10}$Ω	
5	助焊剂+锡线+胶水		＞$1*10^{13}$Ω	$9.9*10^{9}$Ω	

www.stick1mat.com
Email: info@stick1mat.com
上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

储存和使用方法

产品在低于-20 度冷冻环境中储存；使用前需回温解冻处理，解冻过程建议缓慢，30ml 包装需要 2 小时及以上回温；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件;

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。